

電子機器2026 トータルソリューション展

www.jpccashow.com



JPCA 2026 Show
第55回国際電子回路産業展

AI Device Expo
AIデバイス展

WIRE Japan Show 2026
～装置と装置をつなぐ～
電気・光伝送技術展

JIEP 2026
マイクロエレクトロニクスショー
第40回 最先端実装技術・パッケージング展

Electronics Component & Unit Show
JEP 全国電子部品流通連合会
東京部電機部商業協同組合

E-Textile/Wearable
イーテキスタイル/ウェアラブル展

JISSO PROTEC 2026
第27回 実装プロセステクノロジー展

半導体産業展

OSAT SOLUTION SHOW

結果報告書

出展者数：534社 小間数：1,373小間 / 来場者数 49,206名

2026.6.10_{Wed.} → 12_{Fri.} 10:00-17:00

東京ビッグサイト 東展示棟 1・2・3・7ホール

www.jpccashow.com

本部事務局：一般社団法人日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 回路会館 2F TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpca.org

展示会運営事務局：株式会社昭栄美術

〒104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー25F TEL: 03-6675-6809 E-mail: jpca@shoei-bijutsu.co.jp

ご挨拶

「電子機器トータルソリューション展2026 (JPCA Show、マイクロエレクトロニクスショー、JISSO PROTEC、AIデバイス展、WIRE Japan Show、Electronics Component & Unit Show、E-Textile/Wearable、半導体産業展、OSAT Solution Show)」は、2026年6月10日(水)～6月12日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催され、出展者数534社、出展小間数1,373小間で盛況裡に無事終了することができました。

これもひとえに、ご後援を賜りました経済産業省をはじめ、協賛団体各位、ご出展いただきました多くの企業の皆様のご支援とご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。

次回開催は、2027年6月2日(水)～6月4日(金)「電子機器トータルソリューション展2027」を東京ビッグサイト 東展示棟で予定しておりますので、ご出展・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ここに、今回の結果をご報告申し上げますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

実施概要



展示会運営委員会
委員長
高井 建郎



(一社)日本電子回路工業会
会長
小林 俊文



(一社)エレクトロニクス実装学会
会長
日暮 栄治



(一社)日本ロボット工業会
会長
小川 昌寛



(株)産業タイムズ社
取締役会長
泉谷 渉



(株)電線新聞社
電線新聞編集長
井上 政基



全国電子部品流通連合会
会長
屋宮 芳高



一般社団法人
日本 OSAT 連合会会長
澄田 誠

■会 期：2026年6月10日(水)～12日(金)

■開催時間：10:00～17:00

■会 場：東京ビッグサイト東1～3・7ホール

■名 称：**JPCA Show 2026** 第55回国際電子回路産業展

構成展示会：2026 プリント配線板技術展
2026 半導体パッケージング・部品内蔵技術展
フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
2026 機器・半導体受託生産システム展

主 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)

2026 マイクロエレクトロニクスショー 第40回最先端実装技術・パッケージング展

同 時 開 催：最先端実装技術シンポジウム
アカデミックプラザ
eX-tech 2026

主 催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 (JIEP)

JISSO PROTEC 2026 第27回実装プロセステクノロジー展

主 催：一般社団法人日本ロボット工業会

AI Device Expo AIデバイス展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
電子デバイス産業新聞 ((株) 産業タイムズ社)

WIRE Japan Show 2026 電気・光伝送技術展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
電線新聞 ((株) 電線新聞社)

■後 援：経済産業省

■海外協力：世界電子回路業界団体協議会 (WECC) 加盟団体：CPCA (中国電子回路工業協会)、EIPC (欧州電子回路協会)、ELCINA (印度電子工業会)、HKPCA (香港線路板協会)、GEA (グローバル・エレクトロニクス・アソシエーション (米国))、IPCA (印度電子回路工業会)、KPCA (韓国 PCB 半導体パッケージング産業協会)、THPCA (タイ電子回路工業会)、TPCA (台湾回路板協会)

KPIA (Korea Packaging Integration Association)

■本部事務局：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)

■協 賛：映像情報メディア学会、画像センシング技術研究会、画像電子学会、カメラ映像機器工業会、日本フォトイメージング協会、情報サービス産業協会、情報処理学会、全国鍍金工業組合連合会、電気設備学会、電子情報技術産業協会、電子情報通信学会、銅箔工業会、日印国際産業振興協会、日本アミューズメント産業協会、日本医療機器工業会、日本医療機器テクノロジー協会、日本印刷産業連合会、日本オーディオ協会、日本音響学会、日本火災報知機工業会、日本金型工業会、日本機械工業連合会、日本金属熱処理工業会、日本計量機器工業連合会、日本検査機器工業会、日本自動車研究所、日本自動車部品工業会、日本表面真空学会、日本真空工業会、日本精密測定機器工業会、日本電気協会、日本電気計測器工業会、日本電機工業会、日本電気制御機器工業会、日本照明工業会、日本電子部品信頼性センター、日本電線工業会、日本配線システム工業会、日本半導体製造装置協会、日本表面処理機材工業会、日本分析化学会、日本分析機器工業会、日本ベアリング工業会、日本溶接協会、光産業技術振興協会、ビジネス機械・情報システム産業協会、ファインセラミックスセンター、組込みシステム技術協会、日本材料科学会、情報通信ネットワーク産業協会、ソフトウェア協会、日本電子デバイス産業協会、日本ドローンコンソーシアム (JDC)、日本農業機械工業会 (JAMMA)、電気硝子工業会、日本ロボットシステムインテグレータ協会、計測自動制御学会、日本化学繊維協会

■展示会運営事務局：株式会社昭栄美術

Electronics Component & Unit Show

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
全国電子部品流通連合会／東京都電機卸商業協同組合

E-Textile/Wearable

主 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)

半導体産業展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
(株) イノベント



共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)
一般社団法人日本 OSAT 連合会

スポンサーシップ

Platinum Sponsor



Gold Sponsor



Silver Sponsor



Bronze Sponsor



スポンサープログラムの主な内容

●会期前

メールマガジン広告（ヘッダ・センター）
SNS（X）での紹介

●会期前～中

公式サイトトップページバナー

●会期中

北コンコースLEDデジタルサイネージ動画広告掲載、全セミナー会場スクリーンへの社名・ロゴ+動画広告、基調講演スクリーンロゴ投影、基調講演会場スクリーンサイドパネルへのロゴ掲載各ホール入口のゲート上部にロゴ掲載、会場フロアマップへのロゴ掲載

展示会結果概要

展示会・セミナーともに大盛況！

出展者数

534

社・団体

小間数

1,373

小間

来場者数

49,206名

セミナー数

239本

広報活動

(1) 関連業界団体との連携強化

メールマガジンの配信や機関誌への広告掲載など相互の展示会においてプロモーション活動を実施。

(2) 広告掲載媒体（順不同）

エレクトロニクス実装技術／メカトロニクス／電子デバイス産業新聞／電波新聞／電線新聞／化学工業日報／日刊工業新聞

(3) 海外展示会出展・広告掲載実績

2025年 8月20日（水）～22日（金）	タイ：Thailand Electronics Circuit Asia 2025
9月 3日（水）～5日（金）	韓国：KPCA Show 2025
10月22日（火）～24日（木）	台湾：TPCA Show 2025
10月28日（水）～30日（金）	中国（深圳）：CPCA Show Plus 2025
10月28日（水）・29日（木）	中国（深圳）：日中電子回路秋季大会
12月 3日（水）～5日（金）	中国（香港）：HKPCA Show 2025
2026年 3月17日（火）～19日（木）	米国：APEX EXPO 2026
3月24日（火）～26日（木）	中国（上海）：CPCA Show 2026

(4) PRツール製作

国内用招待状（データ配布）、海外用招待状（データ配布）、VIP招待状、ポスター

(5) メールマガジンの配信

関連する業界団体やスポンサー企業などの協力により、会期約3週間前よりメールマガジン配信を実施。

(6) メディア発表会の実施

昨年に引きつづき、開幕に先駆け、5月20日（水）よりオンラインにてメディア発表会を実施。

(7) SNS

(X)にて、イベントの開催告知、来場登録促進、セミナーをはじめとする見どころ紹介を実施。

開会式

●日 時：6月10日（水）9:45～10:00

●会 場：東京ビッグサイト 東7ホール セミナー会場1（基調講演会場）

来賓	渋谷 闘志彦	経済産業省	商務情報政策局大臣官房審議官
開催挨拶	高井 建郎	一般社団法人日本電子回路工業会	展示会運営委員会 委員長 副会長
	日暮 栄治	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	会長
	五十棲 丈二	一般社団法人日本ロボット工業会	副会長
	泉谷 渉	株式会社産業タイムズ社	取締役会長
	井上 政基	株式会社電線新聞	電線新聞編集長
	屋宮 芳高	全国電子部品流通連合会	会長
	堀 正人	株式会社イノベント	取締役代表執行役社長
	LIN XIA	中国電子回路行業協会（CPCA）	Vice Chairman
	Benny YIP	香港線路板協会（HKPCA）	Managing Director
	David Bergman	グローバル・エレクトロニクス・アソシエーション（GEA）	Vice President
	CHOI SI DON	韓国 PCB& 半導体パッケージング産業協会（KPCA）	Chairman
	Pornpisit Nitisuornrat	タイ電子回路工業会（THPCA）	Board of Committee
	Lawrence Chang	台湾電路板協会（TPCA）	Chairman

ウェルカムレセプション

出展企業及び業界関係者約300名が参加。御来賓として、経済産業大臣 政務官 越智俊之 様にご挨拶をいただきました。

●日 時：6月10日（水）17:30～18:30

●会 場：東京ビッグサイト 東7ホール セミナー会場1（基調講演会場）

挨拶	高井 建郎	一般社団法人日本電子回路工業会	展示会運営委員会 委員長 副会長
来賓挨拶	越智 俊之	経済産業省	経済産業大臣政務官
乾杯登壇	越智 俊之	経済産業省	経済産業大臣政務官
	高井 建郎	一般社団法人日本電子回路工業会	展示会運営委員会 委員長 副会長
	日暮 栄治	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	会長
	五十棲 丈二	一般社団法人日本ロボット工業会	副会長
	泉谷 渉	株式会社産業タイムズ社	取締役会長
	井上 政基	株式会社電線新聞	電線新聞編集長
	屋宮 芳高	全国電子部品流通連合会	会長
	森嶋 勝利	株式会社イノベント	執行役員
	山下 博樹	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	小島 正紀	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	倉田 司	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	児嶋 一登	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	LIN XIA	中国電子回路行業協会（CPCA）	Vice Chairman
	Benny YIP	香港線路板協会（HKPCA）	Managing Director
	Pornpisit Nitisuornrat	タイ電子回路工業会（THPCA）	Board of Committee
	Lawrence Chang	台湾電路板協会（TPCA）	Chairman
乾杯発声	五十棲 丈二	一般社団法人日本ロボット工業会	副会長
中締挨拶	日暮 栄治	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	会長



開会式テープカット



越智 俊之経済産業大臣政務官ご挨拶



ウェルカムレセプション鏡開き

学生向けオリエンテーション&ツアー

学生の皆様へ業界についての深い知識と理解を得ていただくために展示会オリエンテーション&ツアーを実施いたしました。
学生の皆様のお立ち寄りを特に歓迎する出展者様には“学生ウェルカムブース”としてご参加いただきました。

●日 時：6月10日（水）・12日（金） 10:30～11:30 オリエンテーション&展示会ツアー

ブースコンテスト

前年に引き続きブースコンテストを実施いたしました。

ブースコンテストは、出展企業の中から、ブースデザインの装飾を対象とした【ナイスデザイン賞】、パッケージブースの効果的利用を対象とした【特別審査員賞】の2つの賞を設け、来場者投票により決定しました。

表彰式 ●日 時：6月12日（金） 10:15 ～ 10:30 ●会 場：東7ホール セミナー会場11



ナイスデザイン賞

【小間番号：3F-22】
株式会社ニコン



特別審査員賞

【小間番号：1A-01】
奥田貿易株式会社



デモンストレーション／体験

●あなたの足、ちゃんと踏ん張れますか？

技術提供：株式会社ニフコ

転倒予防の指標「足把持力」を30秒で測定！

結果判定やトレーニングゲームもできる体験型ツールHAJICHECK（ハジチェック）をお試しいただきました。

●人と空間見守りセンサー

技術提供：株式会社ニフコ

人も空間もリアルタイムでモニタリング可能。空間×人を同時に計測でき、管理・運営の手間とリスクを軽減。

危険エリアを把握可能で、個別センサーで作業者の状況を追跡でき、自動記録で、監査対応・提出資料にもそのまま使える、「人と空間見守りセンサー」を展示しました。

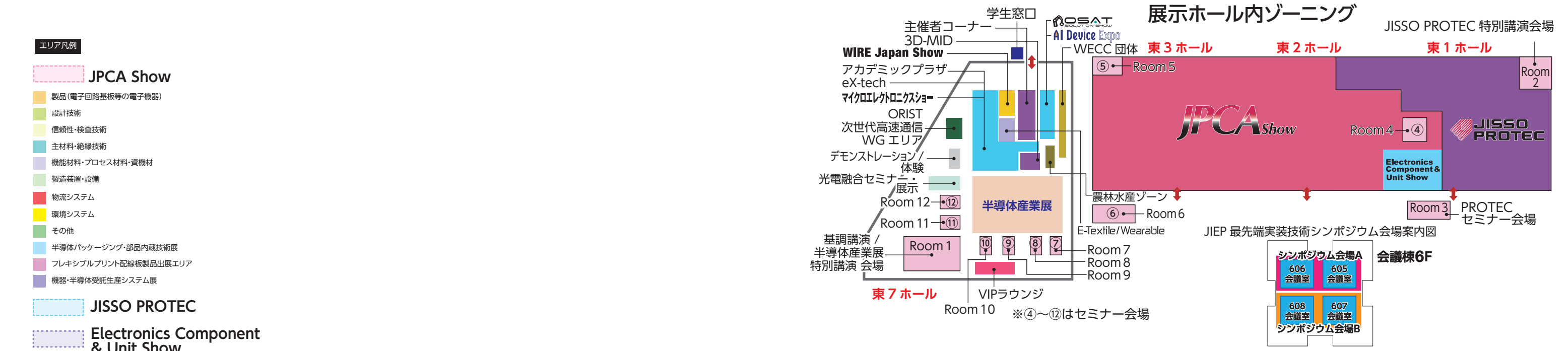
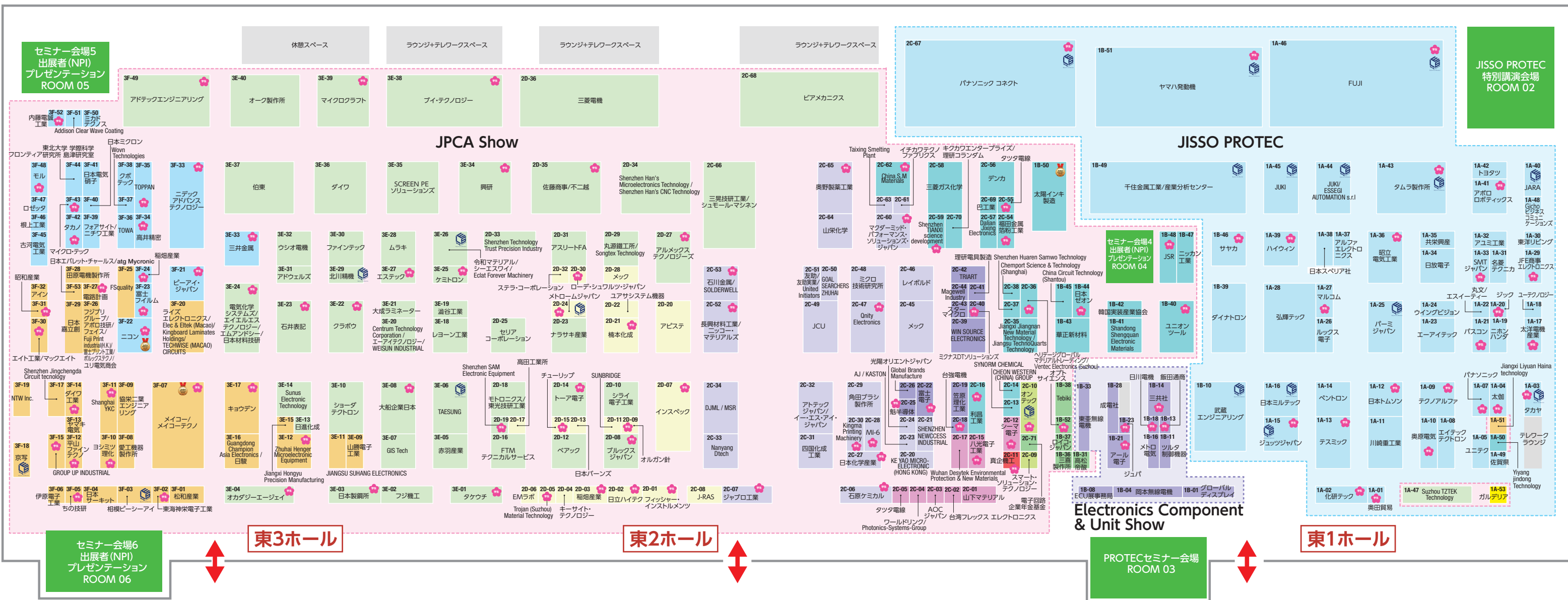
会場レイアウト (東1・2・3ホール)

凡例

JPCA賞・JPCA奨励賞 受賞出展者

学生 ウェルカムブース (2026年5月27日現在)

ELS支持企業・団体



会場レイアウト（東7ホール）



出展者一覧

※五十音順／法人格省略

JPCA Show											
プリント配線板技術展											
国内											
あ	愛工機器製作所	3F-08	J-RAS	2C-08	フェイス	3F-26	KE YAO MICRO-ELECTRONIC (HONG KONG)	2C-20			
	アイン	3F-32	JCU	2C-49	福田金属箔粉工業	2C-54	Kingboard Laminates Holdings	3F-20			
	赤羽産業	3E-05	四国化成工業	2C-31	フジ機工	3E-02	Kingma Printing Machinery	2C-30			
	アスリート FA	2D-31	澁谷工業	3E-19	不二越	2D-35	Korea Packaging Integration Association (KPIA)	1B-42			
	アドウェルズ	3E-31	ジャブロ工業	2C-07	フジブリグループ	3F-26	Korea Semiconductor Packaging and Circuits Association (KPCA)	7A-06			
	アドテックエンジニアリング	3F-49	松和産業	3F-01	富士プリント工業	3F-26	N Nanyang Dtech	2C-33			
	アトテックジャパン	2C-32	昭和産業	3F-31	古河電気工業	7G-01	S Schmoll maschinen GmbH	2C-66			
	アピステ	2D-20	ショーダテクトロン	3E-10	ブルックスジャパン	2D-08	Shandong Shengquan Electronic Materials	1B-41			
	アポロ技研	3F-26	シライ電子工業	2D-10	ヘ	ベアック	2D-12	Shanghai YKC	3F-11		
	アルメックステクノロジーズ	2D-27	信越化学工業	7C-05	ヘリテージグローバルマテリアルレーディング	2C-36	Shenzhen Han's CNC Technology	2D-34			
い	ANVOS Analytics	7G-01	真企機工	2C-11	ほ	ボルックステクノ	3F-26	Shenzhen Han's Microelectronics Technology	2D-34		
	アントンパール・ジャパン	7G-01	新興電気	2C-68	ま	マイクロクラフト	3E-39	Shenzhen Huaren Samwo Technology	2C-37		
	イー・エス・アイ・ジャパン	2C-32	新タック化成	7G-01	マクセル	7C-04	Shenzhen Jingchengda Circuit tecnology	3F-1			
	EM ラボ	2D-06/ 7G-01	SCREEN PE ソリューションズ	3E-35	マクセルフロンティア	7B-06	SHENZHEN NEWCESS INDUSTRIAL	2C-21			
	イーマキーナ	7B-06	ステラ	2C-68	マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン	2C-60	Shenzhen SAM Electronic Equipment	2D-19			
	イオックス	7G-01	ステラ・コーポレーション	2D-32	マジリカ・ジャパン	7G-01	Shenzhen Technology Trust Precision Industry	2D-33			
	石井表記	3E-23	スマート・ソリューション・テクノロジー	2C-09	松尾産業	7G-01	ShenzhenTIANXI science development	2C-59			
	石川金属	2C-53	住友化学	7G-01	マックエイト	3F-30	SOLDERWELL	2C-53			
	石原ケミカル	2C-06	せ	青電舎	7B-06	丸源鐵工所	2D-29	Songtex Technology	2D-29		
	イチカワテクノファブリクス	2C-61	た	セリアコーポレーション	2D-25	み	ミクロ技術研究所	2C-48	Sunus Electronic Technology	3E-14	
う	稲畑産業	2D-03	た	大成ラミネーター	3E-21	め	メイコー	3F-07	Suzhou TZTEK Technology	1A-47	
	伊原電子工業	3F-06	た	太陽インキ製造	1B-50		メイコーテクノ	3F-07	SYNORM CHEMICAL	2C-13	
	インスペック	2D-07	ち	ダイワ	3E-36	む	ムラキ	3E-28	T TAESUNG	3E-06	
	ウシオ電機	3E-32	ち	ダイワ工業	3F-14	め	メイコー	3F-07	Taiwan Printed Circuit Association (TPCA)	7A-09	
	エイエルエステクノロジー	3E-24	ち	高田工業所	2D-17		メック (兵庫)	2C-45	Taixing Smelting Plant	2C-63	
	エイト工業	3F-30	ち	高松帝酸	1B-31		メック (神奈川)	2D-28	TECHWISE (MACAO) CIRCUITS	3F-20	
	エーアイテクノロジー	3E-20	ち	タケウチ	3E-01		メトロームジャパン	2D-24	Thailand Printed Circuit Association (THPCA)	7A-08	
	AJ	2C-23	ち	タツタ電線	2C-55	も	モトロニクス	2D-18	Trojan (Suzhou) Material Technology	2D-05	
	エステック	3E-27	ち	田原電機製作所	3F-28	や	山勝電子工業	3E-09	U United Initiators	2C-51	
	NTW inc.	3F-19	ち	ちの技研	3F-05		ヤマキ電気	3F-13	V Ventec Electronics (Suzhou)	2C-36	
え	FTM テクニカルサービス	2D-16	て	チューリップ	2D-15	ゆ	ユアサシステム機器	2D-22	W WEISUN INDUSTRIAL	3E-20	
	MI-6	2C-28	て	長興材料工業	2C-52		友助	2C-51	Y Yiyang jindong Technology	1A-50	
	エムアンドシー	3E-24	て	角田ブラシ製作所	2C-29		ユニオンツール	1B-40	Yozhu Industry	2C-51	
	MSR	2C-34	て	ティ. エム. ワークス/鹿ソニック	7B-06		ユニチカ	7G-01	Z Zhuhai Henger Microelectronic Equipment	3E-12	
	オーク製作所	3E-40		Tebiki	1B-38	よ	ユリ電気商会	3F-26	3D-MID パビリオン		
	大阪産業技術研究所	7G-01		デンカ	2C-56	ら	ヨシミツ理化	3F-10	国内		
	大船企業日本	3E-08		電気化学システムズ	3E-24	り	ライズエレクトロニクス	3F-20	い	岩手県工業技術センター	7C-25
	オカダジーエージェイ	3E-04		電子回路企業年金基金	2C-71		理研コランダム	2C-70	す	図研	7C-24
	奥野製薬工業	2C-65		電路計画	3F-27	れ	利昌工業	2C-16	た	太陽インキ製造	7C-28/29
	オプトロニクス社	7H-12	と	東海神栄電子工業	3F-02		レイボルド	2C-46	に	日本 MID 協会	7C-26/27
お	オルガン針	2D-09		東京マシン・アンド・ツール	2C-68		令和マテリアル	3E-26	半導体パッケージング・部品内蔵技術展		
	オンテック	2C-10		東光技研工業	2D-18		レヨーン工業	3E-18	国内		
	化学工業日報社	7H-10		東朋テクノロジー	2C-68	ろ	ロイコ・ジャパン	1B-37	い	稲畑産業	3F-24
	華正新材料	1B-43		トーア電子	2D-14		ローデ・シュワルツ・ジャパン	2D-30	う	Wovn Technologies	3F-37
	ガルデリア	1A-53		巴工業	2C-69		海外		お	オプトサイエンス	1B-52
	キーサイト・テクノロジー	2D-04	な	ナラサキ産業	2D-23	A	atg Mycronic	3F-53	く	クボテック	3F-38
	キクカワエンタープライズ	2C-70	に	日亜化学工業	7G-01	C	Centrum Technology Corporation	3E-20	た	タカノ	3F-42
	北川精機	3E-29		ニッカン工業	1B-47		Chemport Science & Technology (Shanghai)	2C-38	と	東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室	3F-44
	Qnity Electronics	2C-47		日刊工業新聞社	7H-11		CHEON WESTERN (CHINA) GROUP	2C-14		TOWA	3F-36
	協栄二葉エンジニアリング	3F-09		ニッコー・マテリアルズ	2C-52		China Circuit Technology (Shantou)	1B-45	な	TOPPAN	3F-35
か	京写	3F-18		日駿	3E-16		China Printed Circuit Association (CPCA)	7A-02	に	内藤電誠工業	3F-52
	京セラ	7C-01		日進化成	3E-13		China S.M Materials Corporation	2C-62		ニコン	3F-22
	キョウデン	3E-17		日本化薬	7G-01	D	Dalian Jixing Electronics	2C-57		ニチワ工業	3F-39
	クオルテック	7G-01		日本ゼオン	1B-44		DJ MicroLaminates	2C-34		日本電気硝子	3F-41
	楠本化成	2D-21		ニフコ	7H-09	E	Eclat Forever Machinery	3E-26		ニデックアドバンステクノロジー	3F-33
	熊本県	7B-05		日本エバレット・チャールス	3F-53		Elec&Eltek (Macao)	3F-20		日本ミクロン	3F-40
	クラボウ	3E-22		日本化学産業	2C-27	F	FSquality	3F-25	ね	根上工業	3F-46
	ケミترون	3E-25		日本サーキット	3F-04		Fuji Print industrial(H.K.)	3F-26	は	パナソニック インダストリー	7C-03
	興研	3E-34		日本材料技研	3E-24	G	GIS Tech	3E-07	ひ	ピーアイ・ジャパン	3F-21
	光陽オリエントジャパン	2C-24		日本嘉立創	3F-29		Global Electronics Association (GEA)	7A-04	ふ	フォアサイト	3F-39
さ	堺化学工業	7G-01	は	日本製鋼所	3E-03		GOAL SEARCHERS ZHUHAI	2C-50		富士フイルム	3F-23
	相模ピーシーアイ	3F-03		日本電子回路工業会 (JPCA)	7I-01		GROUP UP INDUSTRIAL	3F-15		古河電気工業	3F-45
	佐藤商事	2D-35	ひ	日本バーンズ	2D-13		Guangdong Champion Asia Electronics	3E-16	ま	マイクロ・テック	3F-43
	山栄化学	2C-64		Bax	2C-34		Guangdong Chengde Electronic Technology	3F-27	み	ミカドテクノス	3F-50
	三喜製作所	1B-36		ピアメカニクス	2C-68	H	Hong Kong Printed Circuit Association (HKPCA)	7A-05		三井金属	3E-33
	三晃技研工業	2C-66		ピーダブルビー	7G-01	J	JIANGSU SUHANG ELECTRONICS	3E-11	も	モル	3F-48
	SUNBRIDGE	2D-11		光産業技術振興協会	7H-12		Jiangsu TechnoQuarts Technology	2C-35	ろ	ロゼッタ	3F-47
	シーエスワイ	3E-26		日立ハイテック	2D-02		Jiangxi Hongyu Precision Manufacturing	3E-15	海外		
	JSR	1B-48	ふ	平山ファインテクノ	3F-12		Jiangxi Jiangnan New Material Technology	2C-35	A	Addison Clear Wave Coating	3F-51
				フィッシャー・インストルメンツ	2D-01		Jiangxi Liyuan Haina Technology	1A-51	T	TAKAI Precision	3F-34
			ブイ・テクノロジー	3E-38	K	KASTON	2C-23				

フレキシブルプリント配線板製品出展エリア		
国内		
え	AOCジャパン	2C-03
し	シーマ電子	2C-12
た	タツタ電線	2C-05
は	ハ光電子工業	2C-15
む	村田製作所	7C-02
や	山下マテリアル	2C-01
わ	ワールドリンク	2C-04

海外		
P	Photonics-Systems-Group	2C-04
T	taiwan flex electronics	2C-02
W	Wuhan Desytek Environmental Protection & New Materials	2C-17

機器・半導体受託生産システム展		
国内		
か	笠原理化工業	2C-19
さ	魁半導体	2C-25
す	スターマイクロ	2C-43
と	TRIART	2C-42
ふ	富士電子	2C-22
み	ミクナス DT ソリューションズ	2C-40
り	理研電具製造	2C-41
海外		
G	Global Brands Manufacture	2C-26
M	Magewell Industry	2C-44
T	TAI CHYANG ELECTRIC ENG	2C-18
W	WIN SOURCE ELECTRONICS	2C-39

マイクロエレクトロニクスショー		
え	エレクトロニクス実装学会 (JIEP)	7C-23
さ	サンエナジー	7C-06
eX-tech		
あ	愛知製鋼	eX-07
	アイテス	eX-16
	I-PEX	eX-04
	秋田化学工業	eX-39
	actnano Inc	eX-21
	アシストナビ	eX-02
	アテネ	eX-12
	アンドールシステムサポート	eX-24/25
う	ウシオ電機	eX-06
え	エスベック	eX-33
	EGGHEAD	eX-20
	エレファンテック	eX-08
	エンジニアリング・ラボ	eX-34
お	大阪有機化学工業	eX-10
	奥野製薬工業	eX-42
	オジックテクノロジーズ	eX-03
か	カネカテクノリサーチ	eX-35
け	CHEMIPAZ	eX-09
こ	江東電気	eX-13
	コジマプラスチック	eX-05
さ	サーモグラフィティクス	eX-28
し	JNC 石油化学	eX-26
	JSOL	eX-19
	Shimada Appli	eX-17
	新菱	eX-18
た	大洋工作所	eX-22
て	TDK	eX-27
	ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン	eX-30
	TEGソリューション	eX-38
	テクノトロン・サプライ	eX-23
	電気印刷研究所	eX-37
	電子技研	eX-14
と	東洋紡	eX-41
な	長瀬産業	eX-40
に	日邦産業	eX-32
	日本高純度化学	eX-15
の	ノードソン	eX-11
は	パナック	eX-31
	ハニー化成	eX-43
ふ	FUJI	eX-36
	プラズマイオンアシスト	eX-29
ゆ	ユー・コーポレーション	eX-01

アカデミックプラザ		
あ	秋田大学	7E-15
	足利大学	7F-09
お	大阪公立大学	7E-02
	大阪公立大学大学院工学研究科	7E-03
	大阪産業技術研究所	7E-01
	岡山大学 工学部 情報・電気・数理データサイエンス系	7F-06
か	神奈川県立産業技術総合研究所	7F-13
き	九州大学	7F-08
く	群馬大学	7F-10
	群馬大学大学院 理工学府	7F-11
こ	甲南大学	7F-07
し	信州大学 工学部 高効率電力システム (曾根原) 研究室 / Epulse	7E-05
	創成工学部 創成材料システム (曾根原) 研究室 / ナノデバイスデバイス試験室	7E-06
す	崇城大学	7F-04
て	電磁材料研究所	7E-10
と	東京電機大学	7E-14
	東京理科大学	7E-12
	東京理科大学 山本研究室	7E-11
	東北大学 遠藤 (恭)・室賀研究室	7F-02
	東北大学	7F-01
	東北大学 日暮研究室	7F-03
	富山県立大学	7F-05
な	長野工業高等専門学校 高速信号伝送評価センター	7E-08
	長野工業高等専門学校 中山研究室	7E-07
に	日本大学 金子研究室	7E-09
	日本大学理工学部精密機械工学科	7E-13
や	山形大学 フレキシブル基盤技術グループ	7E-16
よ	横浜国立大学	7F-14

JISSO PROTEC		
国内		
あ	アポロロボティックス	1A-41
	アユミ工業	1A-32
	アルファエレクトロニクス	1A-37
う	ウイングビジョン	1A-24
え	エイテックテクトロン	1A-08
	エーアイテック	1A-23
	エスイーティー	1A-22
	SMTジャパン	1A-33
お	奥田貿易	1A-01
	奥原電気	1A-10
か	化研テック	1A-02
	川崎重工業	1A-11
き	Gicho ビジネスコミュニケーションズ	1A-48
	共栄興産	1A-35
こ	弘輝テック	1A-28
さ	佐賀県	1A-49
	サヤカ	1B-46
	産業分析センター	1B-49
し	JFE 商事エレクトロニクス	1A-29
	ジック	1A-20
	JUKI	1A-44/45
	ジュッツジャパン	1A-15
	昭立電気工業	1A-36
せ	千住金属工業	1B-49
た	太加	1A-04
	ダイナトロン	1B-39
	大洋電機産業	1A-17
	タカヤ	1A-03
	タムラ製作所	1A-43
て	テクノアルファ	1A-09
	テスミック	1A-13
と	東洋リビング	1A-30
	トヨタツ	1A-42
に	日放電子	1A-34
	日本トムソン	1A-12
	日本スベリア社	1A-38
	ニホンハンダ	1A-19
	日本ミルテック	1A-16
	日本ロボット工業会 (JARA)	1A-40
は	パーミジャパン	1A-25
	ハイウイン	1A-39
	パスコン	1A-21

	パナソニック	1A-07
	パナソニック コネクト	2C-67
ふ	FUJI	1A-46
ま	マルコム	1A-27
	丸文	1A-22
む	武蔵エンジニアリング	1B-10
め	名菱テクニカ	1A-31
や	ヤマハ発動機	1B-51
ゆ	ユーテクノロジー	1A-18
	ユニテック	1A-05
る	ルックス電子	1A-26
海外		
E	ESSEGI AUTOMATION	1A-44
P	ペントロン	1A-14

AI Device Expo		
く	グロスバーク	7B-08
さ	産業タイムズ社	7B-09
て	Tellus	7B-08

WIRE Japan Show		
国内		
て	電線新聞社	7D-40
に	日本コーティングセンター	7D-04
ほ	ホースパワージャパン	7D-01
海外		
H	Huzhou Shantian Motor	7D-01
K	Kunshan Dayang Printed Circuit Board	7D-01
S	SHENZHEN EAST-TOPTECH	7D-03
T	Taymer International	7D-02

Electronics Component & Unit Show		
あ	アール電子	1B-21
い	飯田通商	1B-13
お	岡本無線電機	1B-04
く	グローバルディスプレイ	1B-01
さ	三共社	1B-14
し	ジュパ	1B-23
せ	成電社	1B-28
	全国電子部品流通連合会 (JEP)	1B-08
つ	ツルタ制御機器	1B-11
と	東亜無線電機	1B-33
	東京都電機卸商業協同組合 (TEP)	1B-08
ひ	日川電機	1B-18
め	メトロ電気	1B-16

E-Textile/Wearable		
あ	AZAYAKA JAPAN	7D-08
え	ENEOS テクノマテリアル	7D-17
	ME テック	7D-05
お	大塚テクノ	7D-12
か	カラキ	7D-13
さ	三機コンシス	7D-07
て	トキスタイル製品化研究会	7D-20
と	Tol Nexus	7D-09
	東京都立産業技術研究センター	7D-19
な	中津山熱処理	7D-16
に	日本航空電子工業	7D-11
は	hap	7D-18
ふ	フューチャーブランド	7D-14
ゆ	ユシロ	7D-06
よ	ヨコオ	7D-15
れ	レクア	7D-10

半導体産業展		
あ	アスカインデックス	7A-16
	アポロ	7B-11
い	インコム	7H-01
え	EIZO	7C-15
	エーエス	7H-04

	エーディーエステック	7F-23
	FPT ジャパンホールディングス	7A-11
	MCC	7D-37
	エルテック	7E-45
か	川瀬産業	7C-14
	河本化成工業	7B-10
き	QMS	7E-47
く	Quanmatic	7H-07
	クボブラ	7B-17
	クリエイティブテクノロジー	7B-14
け	計測エンジニアリングシステム	7E-39
	ケーマックステクノロジー	7B-12
こ	神津精機	7D-34
さ	最先端デジタル SoC 設計人材育成プログラム (ADIP)	7C-13
	サカセ化学工業	7D-39
	坂本電機製作所	7F-26
	産業タイムズ社	7A-12
	santec Japan	7E-42
し	シンコム	7B-16
	シンフォニアテクノロジー	7H-05
せ	清和光学製作所	7F-28
た	第五電子工業	7A-13
	高井電機	7E-43
	竹内精工	7F-27
て	DiaM	7C-17
	テクノハンズ	7E-46
	デロイト トーマツコンサルティング	7H-06
と	東京ダイヤモンド工具製作所	7C-12
	東洋精密工業	7D-35
	徳力本店	7D-38
に	日進工具	7F-29
ね	ネグロス電工	7C-11
は	半導体産業展出展相談カウンター	7B-15
ふ	フィールドマーケティングシステムズ	7C-16
	フォームファクター	7E-40
	フォトニククラティス	7F-24
	フクシマ	7E-38
	物質・材料研究機構	7B-13
へ	ベクトルジャパン	7A-14
ま	マイクロサポート	7E-44
	牧野プライス製作所	7H-02
	松田産業	7C-10
み	三星工業	7E-41
や	山勝商会	7B-19
よ	ヨクスル	7H-08
ら	洛陽化成	7D-36
り	リオン	7E-37
	リンテック	7F-25
ろ	ロキテクノ	7D-33

OSAT SOLUTION SHOW		
あ	アオイ電子	7B-01
	AccoTEST Technology Japan	7B-04
え	エムテックスマツムラ	7B-01
か	加藤電器製作所	7B-01
き	協栄プリント技研	7B-03
こ	コスメック	7B-01
し	シマネ益田電子	7B-01
	新光電気工業	7B-01
て	デンケン	7B-01
に	日本 OSAT 連合会 (J-OSAT)	7B-01
	日本ナショナルインスツルメンツ	7B-01
は	ハマダテクノス	7B-01
ふ	ファースフォードテクノロジ	7B-02
	バイ・テクノロジ	7B-01
ゆ	Youibot Robotics Japan	7B-07
り	菱進テック	7B-01

電子機器トータルソリューション展 基調講演 無料

●日時：6月10日（水）～12日（金） ●会場：東7ホール セミナー会場1 基調講演会場 ●聴講者数：全7セッション 1,794名

6月10日（水）	10:30 ～ 11:20	 半導体産業は2030年に200兆円の巨大市場を構築する！～AIインパクトの凄まじさ、後工程・基板が重要になる展開 泉谷 渉 (株)産業タイムズ社 取締役会長
	11:30 ～ 12:20	 AI時代における『つなぐ技術』の進化と、前工程から見た示唆 柴山 耕一郎 キオクシア岩手(株) 代表取締役社長
	13:00 ～ 14:00	 【特別講演】PCB産業の動向 - 日本企業のとるべき道 Dr. Hayao Nakahara 新N.T. Information, Ltd. CEO
6月11日（木）	10:30 ～ 11:20	 通信と情報処理に変革をもたらすIOWN構想とそれを支える光電融合デバイス技術 竹ノ内 弘和 NTT(株) 先端集積デバイス研究所 所長
	11:30 ～ 12:20	 2030年に向けて加速度的に拡大する半導体市場、AI投資は継続するのか？ 南川 明 OMDIA コンサルティング シニアコンサルティングアドバイザー
6月12日（金）	10:30 ～ 11:20	 日本の実装技術で、世界をつなぐ 川島 知浩 (株)アムコー・テクノロジー・ジャパン 代表取締役社長兼 日本統括責任者
	11:30 ～ 12:20	 先端パネルレベルパッケージの技術開発と応用市場 相沢 吉昭 アオイ電子(株) 先端パッケージ推進本部 取締役

JISSO PROTEC 特別講演 無料

●日時：6月10日（水）～12日（金） ●会場：東1ホール セミナー会場2 特別講演会場 ●聴講者数：全7セッション 455名

6月10日（水）		 スマートフォン・周辺機器、Apple製品、AIサーバーの業界見通し 中根 康夫 みずほ証券(株) エクティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ/シニアアナリスト
6月11日（木）	10:30 ～ 11:20	 GEA(Global Electronics Association: 旧IPC) 規格導入と車載向けはんだ付け外觀基準の標準化日本委員会活動 鈴木 貴人 (株)東海理化 調達企画部 主幹
		 規格カイゼン提案による電子部品の品質向上への取り組み 西森 久雄 トヨタ自動車(株) 電子性能開発部 電子性能開発室 グループ長
6月12日（金）		 2026年度版 JEITA 実装技術ロードマップの紹介 ～実装設備の最新動向～ 前田 憲 パナソニック コネクト(株) 回路形成プロセス事業部 主幹技師 / (一社) 電子情報技術産業協会 (JEITA) JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会 実装設備WG主査

半導体産業展 特別講演 無料

●日時：6月11日（木）～12日（金） ●会場：東7ホール セミナー会場1 半導体産業展特別講演会場 ●聴講者数：全5セッション 967名

6月11日（木）	13:00- 13:50	 半導体政策に見る日本経済復活の道筋 甘利 明 自由民主党 元幹事長 / 自由民主党 半導体戦略推進議員連盟 名誉会長
	14:20- 15:10	 半導体の世紀 黒田 忠広 東京大学 特別教授 / 熊本県立大学 理事長
	15:40- 16:30	日本の半導体産業の将来に向けて 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体戦略室
6月12日（金）	13:00- 13:50	 九州半導体の現在地と産業界(SIIQ)の取り組み 前田 憲 パナソニック コネクト(株) 回路形成プロセス事業部 主幹技師 / (一社) 電子情報技術産業協会 (JEITA) JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会 実装設備WG主査
	14:20- 15:10	 半導体産業における最新トピックス 貴志 隆博 (同) デロイト トーマツ パートナー / 熊本半導体ビジネス室 室長  内倉 要 (同) デロイト トーマツ シニアマネジャー 半導体セクター / 熊本半導体ビジネス室 副室長 他

JIEP 最先端実装技術シンポジウム 有料

●日時：6月10日（水）～12日（金） ●会場：最先端実装技術シンポジウム A会場・B会場（会議棟 6F） ●聴講者数：5,304名

A 会場（会議棟605・606）			B 会場（会議棟607・608）		
6月10日（水）	10A-1	B5G/6Gに対応する高周波基板材料開発 座長：松本 博文、高野 希	10B-1	光電融合技術：Co-Packaged Optics の最新動向 座長：中條 徳男、長島 和哉	
	10:00-10:50	10A1-1 Beyond5Gに向けた高速通信用途向け基板材料の開発動向 広川 祐樹 パナソニック インダストリー(株) 電子材料事業部 電子基材BU 技術一部 技術一課 課長	10B1-1	光電融合パッケージ基板の最新動向 天野 建 産業技術総合研究所 光電融合研究センター 研究センター長	
	10:50-11:40	10A1-2 Beyond5G向け低伝送損失/低熱膨張基板材料開発動向 谷川 隆雄 (株)レゾナック エレクトロニクス事業本部 開発センター 積層材料開発部 チームリーダー	10B1-2	加速する光化：Co-Packaged Optics の最新動向と実装技術 大石 恵 京セラ(株) 研究開発本部 フォトニクス事業開発部 係責任者	
	11:40-12:30	10A1-3 最新 PTFE 多層 PCBソリューションと超低 Dk・Df の PTFE 低損失材料 奥長 剛 (株)PILLAR プロセス部 基板技術グループ 課長	10B1-3	高性能で高効率な次世代 AI ファクトリーを実現するための最先端実装技術とその効果 愛甲 浩史 エヌビディア(同) エンタープライズマーケティング シニアマーケティングマネージャー	
	10A-2	高周波・高速伝送を支える先端配線板&モジュール 座長：谷 元昭、佐藤 牧子	10B-2	半導体の経営戦略を探る 座長：土門 孝彰、森川 泰宏	
	13:30-14:20	10A2-1 光に切り替わるAI時代のプリント配線板と必要とされる材料について 飯長 裕 OKIサーキットテクノロジー(株) マーケティング部 部長	10B2-1	AIの急速な進化が、半導体の技術進化を加速させる 山本 義継 みずほ証券(株) エキティ調査部 シニアアナリスト	
6月11日（木）	14:20-15:10	10A2-2 プリント配線板の技術動向と高周波・高速伝送に向けた取り組み 戸田 光昭 (株)メイコー 協調設計開発室 室長	10B2-2	衝撃の半導体マーケット・ダイナミズムへマーケティング・メトリクスで読み解く 永田 隆一 アンカー・ビジネス・システム(株) 代表取締役社長	
	15:10-16:00	10A2-3 ミリ波帯アンテナ一体型モジュール技術と6Gに向けた取り組み 須藤 薫 (株)村田製作所 技術・事業開発本部 共通基盤技術センター 設計プロセス開発部 高周波技術開発課 プリンシパルリサーチャー	10B2-3	半導体の経営戦略を探る 大山 聡 グロスバーク(同) 代表	
	11A-1	高機能・高密度化を実現する配線板製造技術 座長：佐藤 牧子、北原 悠平	11B-1	今、Foundaryが熱い!Foundaryの取り組み/現状と課題 座長：西田 秀行、森川 泰宏	
	10:00-10:50	11A1-1 次世代SAP対応無電解銅めっき開発とナノボイド解析 吉田 伸一郎 上村工業(株) 開発本部 中央研究所 第二開発部 主任研究員	11B1-1	メイド・イン・ジャパンの挑戦：チップレット技術が拓く新次元への道 折井 靖光 Rapidus(株) エンジニアリングセンター 専務執行役員・エンジニアリングセンター長	
	10:50-11:40	11A1-2 メックの異方性エッチング技術による高密度配線の実現 熊崎 航介 メック(株) 研究開発本部 技術開発センター チーム長	11B1-2	The Future of Advanced Package for AI Application 古谷 俊樹 日本サムスン(株) 常務	
	11:40-12:30	11A1-3 先端パッケージにおける露光技術とエキシマ加工技術の現状と展望 佐藤 仁 (株)オーク製作所 CEO 統括室 執行役員	11B1-3	AIの進化に不可欠な先端パッケージング技術 安原 隆太郎 TSMCジャパン3DIC研究開発センター プロセスインテグレーション部門 テクニカルマネージャー	
6月12日（金）	11A-2	進化するパッケージ基板・インターポーザ 座長：谷 元昭、北原 悠平	11B-2	モビリティエレクトロニクスの現状=車載と宇宙産業機器における実装技術= 座長：加藤 義尚、三宅 敏広	
	13:30-14:20	11A2-1 チップレット集積技術の最新動向 栗田 洋一郎 東京科学大学 未来産業技術研究所 特任教授	11B2-1	モノづくりの力で実現する宇宙産業の変革 中山 聡 インターステラテクノロジズ(株) 開発部 代表取締役 President	
	14:20-15:10	11A2-2 フリップチップ・パッケージにおける放熱の課題とそれに対する取り組み 松本 圭司 日本アイ・ピー・エム 東京基礎研究所 セミコンダクター スタッフ・リサーチ・サイエンティスト	11B2-2	宇宙用電子機器における実装技術の信頼性確保に向けた取り組み 中川 剛 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 安全・信頼性推進部ミッション保証技術グループ グループ長	
	15:10-16:00	11A2-3 半導体パッケージ基板向け層間絶縁材料と加工技術の開発について 廣庭 大輔 味の素ファインテック(株) 研究開発部 アシスタントマネージャー	11B2-3	電動車（xEV）におけるパワー半導体・受動素子・冷却機構実装技術最前線 山本 真義 名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授	
	12A-1	応用広がる3次元実装技術の最新動向 座長：松澤 浩彦、中澤 正志	12B-1	業界のブレイクが予測されるこれからの業界動向！5年後/10年後の半導体パッケージはどうなる？ 座長：西田 秀行、齊藤 雅之	
	10:00-10:50	12A1-1 3D 集積技術の進化と産業展開 ― 技術潮流と今後の方向性 ― 井上 史大 横浜国立大学 半導体量子集積エレクトロニクス研究センター 副センター長・教授	12B1-1	最新パッケージにおけるサプライチェーン動向 ～日本が技術の中心に、供給のボトルネックに～ 亀和田 忠司 AZ Supply Chain Solutions ビジネスコンサルティング オーナー	
6月12日（金）	10:50-11:40	12A1-2 3次元積層技術を用いた3Dフラッシュメモリデバイスの技術動向、技術課題と取り組み 田上 政由 キオクシア(株) 先端メモリ開発センター グループマネージャー	12B1-2	フィジカルAI時代におけるチップレットパッケージ - パネルサイズ製造への期待 西尾 俊彦 (株)SBRテクノロジー 代表取締役	
	11:40-12:30	12A1-3 CMOSイメージセンサにおける3次元実装技術 香川 恵永 ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) 第二研究部門 統括部長	12B1-3	Cloud AI 時代のメガパッケージ化と材料・装置・プロセスの新展開 市川 公也 3DIC リサーチラボ(同) リサーチ&コンサルティング Technical Director	
	12A-2	チップレット/3D構造を実現するインターコネクション技術 座長：土門 孝彰、菊池 浩一	12B-2	加速するガラスサブストレート技術開発の最新動向 座長：加藤 義尚、小岩 一郎	
	13:30-14:20	12A2-1 WOW/COWハイブリッドプロセス用いた三次元集積システム 大場 隆之 東京科学大学 WOW Alliance異種機能集積研究ユニット 特任教授	12B2-1	最新ヘテロジニアス・インテグレーションとガラス・サブストレートの開発状況 宇都宮 久修 インターコネクション・テクノロジーズ(株) 代表取締役	
	14:20-15:10	12A2-2 チップレット/3D構造を実現するインターコネクション樹脂技術 ～ポリマーハイブリッド接合・転写/Fusion接合・再配線・放熱・シーリング～ 藤原 健典 東レ(株) 電子情報材料研究所 リサーチダイレクター	12B2-2	次世代半導体パッケージの高機能化に向けたガラス多層化技術 雨宮 隆久 FICT(株) 代表取締役社長	
	15:10-16:00	12A2-3 エキシマレーザを用いた次世代実装技術 及び パッケージ基板・RDL 加工の最新技術革新 山崎 環一郎 信越化学工業(株) 微小材料システム事業推進室 マネージャー	12B2-3	AI データサーバー向けガラスサブストレート 倉持 悟 大日本印刷(株) ファインパッケージング本部 フェロー	

出展者セミナー 無料

1) 出展者 (NPI) プレゼンテーション

●日時: 6月10日 (水) ~12日 (金) ●会場: 東1・3・7ホール セミナー会場4・5・6・7・10・11 ●聴講者数: 全55セッション 1,510名

●発表出展会社

(株)魁半導体 / ダイナトロン(株) / (株)オンテック / (株)ニコソ / MacDermid Alpha Electronic Solutions / UNITED INITIATORS (SHANGHAI) / タツタ電線(株) / Tebiki(株) / 高松帝酸(株) / 根上工業(株) / 日本化学産業(株) / (株)オジックテック / ロジーズ / レーザーセル(株) / MI-6(株) / 京セラ(株) / (株)オーク製作所 / (株)セリアコーポレーション / (株)セリアエンジニアリング / (株)図研 / EMラボ(株) / 石原ケミカル(株) / 島根県産業技術センター / (株)ブルックスジャパン / 石川金属(株) / 澁谷工業(株) / (株)カネカテクノリサーチ / シライ電子工業(株) / 三井金属(株) / 奥野製薬工業(株) / 三見技研工業(株) / (株)三共社 / ユニオンツール(株) / 電路計画・成徳科技 / (株)マイクロサポート / 日本電気硝子(株) / メック(株) / アンドールシステムサポート(株) / 富士フイルム(株) / (株)JSOL / 大阪有機化学工業(株) / ティー・エイ・インストルメント・ジャパン(株) / TDK (株)

2) 第22回 JPCA 賞 (アワード) 受賞者

この度、JPCA 賞 (アワード) 選考委員会にて、厳正なる審査の上、第22回 JPCA 賞 (アワード) 受賞企業が下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。JPCA 賞 (アワード) は、参加企業の中から、応募のあった発表内容の『独創性 (独自性・オリジナリティ)』、『産業界での発展性・将来性』、『信頼性』、『世時の適合性』を審査基準として、学术界、電子回路業界、専門誌編集者等有識者の方々で構成する JPCA 賞 (アワード) 選考委員会によって厳正な審査を行い、電子回路技術及び産業の進歩発展に顕著な製品・技術への表彰制度として2005年より実施しています。

【表彰式】 ●日時: 6月10日 (水) 16:40~17:00 ●会場: 東7ホール セミナー会場7

JPCA 賞	
■ガラス貫通基板の新規導電層形成工法となるめっきプライマー材料の開発	株式会社イオックス
■PAP (Photo Assist Patterning) 光応答性表面処理材料を用いた難めっき基板への回路形成技術	株式会社ニコソ
■アルミ配線多層基板	株式会社メイコー
JPCA 奨励賞	
■世界初の無溶剤型絶縁剤を選択的に高速塗布可能な塗布システム	Shimada Appli 合同会社
■次世代高速通信基板向け穴埋めインキ	太陽インキ製造株式会社



3) PROTEC セミナー

●日時: 6月10日 (水) ~12日 (金) ●会場: 東1ホール セミナー会場3PROTECセミナー会場 ●聴講者数: 全12セッション 586名

	6月10日 (水)	6月11日 (木)	6月12日 (金)
11:45-12:30	光電融合・先端 PKG 実装を切り拓く精密液体制御技術 上久保 尚 武蔵エンジニアリング(株) マーケティング戦略部 統括課長	コンパクト汎用機 CLT-FG コンパクトで、頼れる実力派 西山 謙 (株)FUJI ロボットソリューション事業本部 機械技術部 第2設計課 課長	実装限界ゼロ始動 — 世界初! 016008実装、その本質は“あらゆる実装品質の証明”にある — 武野 祐丸 (株)FUJI ロボットソリューション事業本部 マーケティング部 プロダクトマーケティング課 マーケティングアナライザー/エバンジェリスト
12:55-13:40	Beyond Automation — 自律生産の実現を目指す FUJI Smart Factory の進化 — 加藤 大輔 (株)FUJI ロボットソリューション事業本部 スマートファクトリー開発部 部長	SMT 検査工程の省人化を実現する最新 AI 活用ソリューション 河合 秀幸 ヤマハ発動機(株) ロボティクス事業部技術統括部 SMT 第1開発部 部長	実装工程の品質を飛躍的に向上! 最新はんだ印刷技術の基礎と実践的最適化手法 豊田 奨 パナソニック コネクト(株) 回路形成プロセス事業部 プロダクト開発センター 機構開発部 機構プラットフォーム開発課 印刷機プロダクト エキスパート
14:05-14:50	実装工程の品質を飛躍的に向上! 最新はんだ印刷技術の基礎と実践的最適化手法 豊田 奨 パナソニック コネクト(株) 回路形成プロセス事業部 プロダクト開発センター 機構開発部 機構プラットフォーム開発課 印刷機プロダクト エキスパート	【事例から読み解く】部品挿入工程の自動化と技術ポイント 中川 貴之 JUKI(株) 産機ユニット 営業部 営業技術課	実務で役立つクリームはんだ印刷技術2026 若林 利昌 ヤマハ発動機(株) ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 営業部 SP グループ 印刷プロセスエンジニア
15:15-16:00	実務で役立つクリームはんだ印刷技術2026 若林 利昌 ヤマハ発動機(株) ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 営業部 SP グループ 印刷プロセスエンジニア	実装工程の品質を飛躍的に向上! 最新はんだ印刷技術の基礎と実践的最適化手法 豊田 奨 パナソニック コネクト(株) 回路形成プロセス事業部 プロダクト開発センター 機構開発部 機構プラットフォーム開発課 印刷機プロダクト エキスパート	パワー半導体分野における実装技術トレンド 早川 めぐ美 千住金属工業(株) 研究開発本部 ハンダテクニカルセンター 研究員

4) 半導体産業展 専門セミナー

●日時：6月10日（水）～12日（金） ●会場：東7ホール セミナー会場12 ●聴講者数：全5セッション 90名

●発表出展会社・団体：計測エンジニアリングシステム(株) / (株)マイクロサポート / BHオフィス / (株)フィールドマーケティングシステムズ / FPTジャパンホールディングス(株)

5) 3D-MIDパビリオンセミナー

●日時：6月10日（水）～12日（金） ●会場：東7ホール セミナー会場9 ●聴講者数：全9セッション 130名

●発表出展会社・団体
日本MID協会 / (地独)岩手県工業技術センター / (株)電気印刷研究所 / 日本MID協会・三共化成(株) / (株)F U J I 開発センター / 電子情報技術産業協会(JEITA)・電子実装技術標準化専門委員会 / (株)図研

6) JIEP アカデミックプラザ

●日時：6月10日（水）～12日（金） ●会場：東7ホール セミナー会場9 ●聴講者数：全26セッション 442名

●発表出展会社・団体
東北大学 / 岡山大学 / 東京工芸大学 / 同志社大学 / 日本大学 / 群馬大学 / 長野工業高等専門学校 / 山形大学 / 甲南大学 / 秋田大学 / 富山県立大学 / 崇城大学 / 信州大学

7) 2026アカデミックプラザ 受賞者

アカデミックプラザで発表される研究発表論文の中から、JIEP 展示会委員会（越地委員長：東京電機大学 工学部 電子システム工学科、大学院 工学研究科 電子システム工学専攻、大学院 先端科学技術研究科 電気電子システム工学専攻 教授）で優秀な論文内容が選考され、アカデミックプラザ賞受賞者が決定いたしました。

【表彰式】 ●日時：6月10日（水） 16:40～17:00 ●会場：東7ホール セミナー会場9

アカデミックプラザ賞【受賞者】

■低温ヘテロジニアス集積のためのAu薄膜転写を応用した接合面の平滑化およびマイクロバンプ接合の研究	東北大学 大学院工学研究科 電子工学専攻 後藤 慎太郎／竹内 魁／日暮 栄治
■USB2.0通信の電磁的情報漏洩実験系の構築と盗聴防止を目的とした漏洩メカニズムの解明	岡山大学大学院環境生命自然科学研究科 岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域 川井 佑真 五百旗頭 健吾
■プリント基板のCuダイレクトレーザビアホール加工における絶縁層ガラスクロス2枚積層が加工穴直径に与える影響に関する考察	同志社大学大学院理工学研究科 同志社大学理工学部 森下 航平／藤本 拓人 中川 正夫／廣垣 俊樹
■左右ボールねじカウンタバランス制振機構を有する穴あけ工作機械によるプリント基板のマイクロドリル加工におけるサイクルステップ動作の検討	同志社大学大学院理工学研究科 同志社大学理工学部 結城 要 中川 正夫／廣垣 俊樹
■スイッチング電源など開回路の導線内循環電流について	信州大学 工学部 工学科 電気電子コース 高効率電力システム研究室 (HePS) 宝本 学大／曾根原 誠

アカデミックプラザ5年連続賞

信州大学 工学部 工学科 電気電子コース 高効率電力システム（曾根原）研究室



主催者セミナー

●ダントツものづくりセミナー

無料

●日時：6月10日（水）～12日（金） ●会場：東7ホール セミナー会場8 ●聴講者数：全7セッション 415名

6月10日（水）			6月11日（木）			6月12日（金）		
生産性向上ものづくりDX特別セッション			トヨタ式現場管理と改善取組・成果セッション			TOC/管理会計セッション		
13:00 ～ 13:45		0610TK 【特別基調講演】 DX時代の地域スクール/JPCAものづくりアカ デミー 藤本 隆宏 東京大学名誉教授/東京理科大学上席特任教授/ 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター顧問・招聘研究員	13:00 ～ 13:45		0611T3 【特別講演3】 飛躍的な生産性を実現する 全体最適の働き方イノベーション 岸良 裕司 ゴールドラット・ジャパン CEO	13:00 ～ 13:45		0612T7 【特別講演7】 電子回路ものづくり企業の「現場改善」について 「お金の良い流れ」から考える 柊 紫乃 愛知工業大学経営学部経営学科教授
13:45 ～ 14:30		0610TK 【特別基調講演】賃金上昇、人手不足、原材料 高騰の中での電子回路業界活性化は生産性向上 しかない！ 藤本 隆宏 東京大学名誉教授/東京理科大学上席特任教授/ 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター顧問・招聘研究員	13:45 ～ 14:30		0611T4 【特別講演4】 月曜日を楽しみな会社にしよう！ ～全体最適のマネジメント理論TOCとは～ 岸良 裕司 ゴールドラット・ジャパン CEO	13:45 ～ 14:30		0612T8 【特別講演8】 経営者は何を管理すれば現場改善効果を 見える化できるのか「現場改善会計（GKC）」 柊 紫乃 愛知工業大学経営学部経営学科教授
14:35 ～ 15:20		0610T1 【特別講演1】 2026年後半の日本経済・産業 鍋山 徹 (一財)日本経済研究所 コンサルティングフェロー	14:35 ～ 15:20		0611T5 【特別講演5】 トヨタ式現場管理 田中 正知 トヨタ自動車OBものづくり大学名誉教授/ J-コスト研究所代表	14:35 ～ 15:35		0612S0 JPCAものづくり大賞/準大賞受賞（2024年度） 改善取組事例報告4件 大賞受賞：微愛工機器製作所 プリント基板事業部 準大賞受賞：FICT(株) 長野本社工場 京号 G 三和電子(株) 岡山本社工場 (株)ダイワ工業 本社工場
15:20 ～ 16:05		0610T2 【特別講演2】 2027年の経済・産業展望 鍋山 徹 (一財)日本経済研究所 コンサルティングフェロー	15:20 ～ 16:05		0611T6 【特別講演6】 現場改善のJコスト理論による 強化策（ROA） 田中 正知 トヨタ自動車OBものづくり大学名誉教授/ J-コスト研究所代表	15:40 ～ 16:10	講師都合により中止	

●ぷりんとばんじゅくセミナー

無料

●日時：6月10日（水）～12日（金） ●会場：東7ホール セミナー会場7 ●聴講者数：全5セッション 280名

6月10日（水）	13:00-14:00	プリント配線板全般の基礎“ぷりんとばんじゅくⅠ”をもとに解説	榎場 正男 (株)カヤバオフィス 代表取締役
	14:15-15:15	フレキシブル配線板の基礎“ぷりんとばんじゅくⅦ”をもとに解説	宮崎 博明 元MFインフォメーション(株) 代表
6月11日（木）	11:00-12:00	プリント配線板設計の基礎	嶋田 茂晴 JPCA認定PWBコンサルタント 1級プリント配線板技能士（設計）
6月12日（金）	13:00-14:00	実装の基礎“ぷりんとばんじゅくⅤ”をもとに解説	榎場 正男 (株)カヤバオフィス 代表取締役
	14:15-15:15	品質管理の基礎“ぷりんとばんじゅくⅢ”をもとに解説	安井 博文 安井事務所 PWBコンサルタント

●魁半導体セミナー

無料

●日時：6月10日（水） ●会場：東1ホール JISSO PROTEC 特別講演会場 ●聴講者数：全1セッション 24名

6月10日（水）	12:00-12:45	プラズマ表面改質による材料・部品の機能向上 ー 濡れ性改善・密着性向上・撥水处理・薄膜形成等におけるプラズマ活用事例 ー	西田 弥奈 (株)魁半導体 プロセス開発部 サブチーフ
----------	-------------	---	-----------------------------

●化学物質伝達ツール解説セミナー

無料

●日時：6月12日（金） ●会場：東1ホール JISSO PROTEC 特別講演会場 ●聴講者数：全2セッション 30名

6月12日（金）	13:30-14:30	CMPの全体解説と今秋運用開始に向けて	森 伸明 CMPコンソーシアム・CMP仕様検討委員会 委員長
	15:00-16:00	自動車向け化学物質伝達ツールIMDS活用の概説	藤木 智之 (一社)日本電子回路工業会 参事

●PWBコンサルタントによるセミナー

有料

●日時：6月10日（水）～12日（金） ●会場：会議棟609 ●聴講者数：全8セッション 76名

6月10日（水）	11:00-12:00	多層リジッドプリント配線板の製造方法 初級～中級編	一色 和彦 (株)ちの技研 代表取締役社長（JPCA認定PWBコンサルタント）
	12:30-13:30	基板の環境対応について技術営業セミナー	中山 務 富士プリント工業(株)（JPCA認定PWBコンサルタント）
	14:00-15:00	プリント配線板における要素技術 初級編	渡邊 喜夫 JPCA認定PWBコンサルタント
	15:30-16:30	プリント配線板の品質保証 初級～中級編（予防処置、是正処置並びに信頼性について）	保坂 三喜雄 JPCA認定PWBコンサルタント
6月12日（金）	11:00-12:00	プリント配線板の品質・製造技術 ～こまごとの解決に向けて①プリント基板、自工程完結、回路形成工程にて説明	渡辺 正 JPCA認定PWBコンサルタント
	12:30-13:30	プリント配線板の品質・製造技術 ～こまごとの解決に向けて②印刷～	一色 和彦 (株)ちの技研 代表取締役社長（JPCA認定PWBコンサルタント）
	14:00-15:00	プリント配線板のめっき技術 ～無電解めっきと電気めっきの基礎～	渡邊 喜夫 JPCA認定PWBコンサルタント
	15:30-16:30	セットメーカー向け ～あとから困らないプリント配線板の調達～	伊藤 直樹 JPCA認定PWBコンサルタント

主催者セミナー

●AIデバイス展セミナー

無料

●日時：6月12日（金） ●会場：東3・7ホール セミナー会場6・11 ●聴講者数：全4セッション 213名

6月10日（水）	14:15-15:15	進化するAI時代を勝ち抜くための半導体戦略	大山 聡 グロスバーク（同）代表
	15:30-16:30	AI用半導体パッケージと受動部品の動向	斐 秀樹（株）産業タイムズ社 編集委員（事業開発部 部長）
6月12日（金）	14:15-15:00	衛星データを活用した新事業に挑戦	菅谷 智洋（株）Tellus
	15:15-16:00	宇宙向けAI&半導体の市場動向	斐 秀樹（株）産業タイムズ社 編集委員（事業開発部 部長）

●WIRE Japan Show セミナー

無料

●日時：6月11日（木）・12日（金） ●会場：東7ホール セミナー会場7・10 ●聴講者数：全2セッション 42名

6月11日（木）	(株)HCIの紹介 ものづくりの現場～海外市場および開発動向について～ 日本の勝ち筋～スマート化・ロングテール市場のロボット・フィジカルAI～		
	14:00-15:00	奥山 浩司（一社）日本ロボット工業会 理事 / (一社)日本ロボットシステムインテグレータ協会 副会長 / (株)HCI 代表取締役社長	井上 政基（株）電線新聞社 電線新聞編集長
6月12日（金）	ロボットとEVにまつわる海外と日本の動向について		
	15:00-16:00		井上 政基（株）電線新聞社 電線新聞編集長

●ORIST 次世代高速セミナー

無料

●日時：6月10日（水）～12日（金） ●会場：東7ホール セミナー会場主催者企画セミナー ORIST展（ブース内）

	6月10日（水）	6月11日（木）	6月12日（金）
11:30-11:40	界面が見えないと、なぜ実装は止まるのか？—SFGによる分子レベル評価の手法 花牟禮 慎也 ANVOS Analytics(株) 取締役COO	高機能樹脂素材のご紹介 長谷川 篤彦 日本化薬(株) ファインケミカルズ研究所 第1グループ 担当リーダー	次世代通信デバイス用材料のレオロジー特性評価 河西 隆太 (株)アントンパール・ジャパン / (株)ビジネスユニットキャラクタリゼーション 粘弾性プロダクト マネージャー
11:40-11:50	めっきプライマー「メタロイド」の石英への適用 中澤 悠人 (株)イオックス 研究開発部	半導体パッケージ基板レーザ加工技術と、フェムト秒レーザ“非加熱加工”応用事例紹介 池本 裕 (株)クオルテック 新規開発事業部 技術	放熱フィラーとしての酸化亜鉛 西川 由唯 堺化学工業(株) 研究開発本部 小名浜開発部
11:50-12:00	TD-NMR(時間領域NMR)を用いた粉体の濡れ性および高濃度分散体の非破壊評価法の提案 池田 純子 マジェリカ・ジャパン(株) 代表取締役 / 東北大学多元物質科学研究所 客員准教授	高速通信・半導体パッケージを支える樹脂・フィルム資材 宮西 健次 ユニチカ(株) 技術企画管理室 グループリーダー	新タック化成(株)受託塗工サービスについて 村井 徹 新タック化成(株) 営業本部 上級調査役
14:00-14:10	次世代通信デバイス用材料のレオロジー特性評価 河西 隆太 (株)アントンパール・ジャパン / (株)ビジネスユニットキャラクタリゼーション 粘弾性プロダクト マネージャー	界面が見えないと、なぜ実装は止まるのか？—SFGによる分子レベル評価の手法 花牟禮 慎也 ANVOS Analytics(株) 取締役COO	高機能樹脂素材のご紹介 長谷川 篤彦 日本化薬(株) ファインケミカルズ研究所 第1グループ 担当リーダー
14:10-14:20	放熱フィラーとしての酸化亜鉛 西川 由唯 堺化学工業(株) 研究開発本部 小名浜開発部	めっきプライマー「メタロイド」の石英への適用 中澤 悠人 (株)イオックス 研究開発部	半導体パッケージ基板レーザ加工技術と、フェムト秒レーザ“非加熱加工”応用事例紹介 池本 裕 (株)クオルテック 新規開発事業部 技術
14:20-14:30	新タック化成(株)受託塗工サービスについて 村井 徹 新タック化成(株) 営業本部 上級調査役	TD-NMR(時間領域NMR)を用いた粉体の濡れ性および高濃度分散体の非破壊評価法の提案 池田 純子 マジェリカ・ジャパン(株) 代表取締役 / 東北大学多元物質科学研究所 客員准教授	高速通信・半導体パッケージを支える樹脂・フィルム資材 宮西 健次 ユニチカ(株) 技術企画管理室 グループリーダー
14:30	大阪産業技術研究所	大阪産業技術研究所	大阪産業技術研究所

●E-Textile/Wearable展セミナー

無料

●日時：6月10日（水）～12日（金） ●会場：東7ホール セミナー会場主催者企画セミナー E-Textile/Wearable展（ブース内）

6月10日（水）	10:30-11:10	椅子は「デバイス」へ。AI×スマートテキスタイルが導くあなたの「正解姿勢」	加藤 幸子（株）AZAYAKA JAPAN 代表取締役
	11:10-11:50	スマートテキスタイル×AIの融合	西谷 颯哲（株）Tol Nexus 代表取締役
	13:30-14:10	竹由来の炭素繊維が切り拓く次世代導電性素材	瀬戸 祐志（株）中津山熱処理 研究開発センター R&B推進部 部長
	14:20-15:00	「未来の服は、あたたかだけじゃない。」—発熱・センシング・快適性を融合するスマートテキスタイル技術	松本 正秀（株）三機コンシス 代表取締役
	15:10-15:50	t-テキスタイル製品化研究会のご紹介 佐脇 政孝 t-テキスタイル製品化研究会 / 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 特任技術アドバイザー	
6月11日（木）	11:10-11:50	脳出血からの再起と次世代ウェアラブル：—スマートウェア『COVEROSS®』が変える「リハビリ・リカバリー」の常識—	鈴木 素 hap(株) 代表取締役
	13:30-14:10	自己修復性・タフネス性を実現したWIZARD Seriesの紹介	中野 浩平（株）ユシロ イノベーション推進部 研究開発セクション
	15:10-15:50	t-テキスタイル製品化研究会のご紹介 佐脇 政孝 t-テキスタイル製品化研究会 / 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 特任技術アドバイザー	
6月12日（金）	15:10-15:50	t-テキスタイル製品化研究会のご紹介 佐脇 政孝 t-テキスタイル製品化研究会 / 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 特任技術アドバイザー	

主催者セミナー

●他ではゼットイ聞けない「主催者セミナー」無料

●日時：6月10日（水）・12日（金） ●会場：東7ホール セミナー会場11 ●聴講者数：全6セッション 360名

6月10日（水）		6月12日（金）	
最先端パッケージング、基板技術		エレクトロニクスの新たな用途を考えるプログラム	
13:00-14:00	初出展!中空構造で超低損失基板を実現 ULTICIRC (株)村田製作所 通信・センサ事業本部 通信モジュール事業部 プリンシパルエンジニア 池本 伸郎	13:00-13:30	【特別講演】アーバン・ワイルドライフとゾーニング管理 酪農学園大学 農食環境学群 環境共生学類 野生動物生態学研究室 教授 佐藤 喜和
14:00-15:00	既存PCB工程&フィルム型基板材料を活用したプリント配線板の高周波対応・微細化対応～10um以下の平滑なCu回路を有するプリント配線板製造の新たな選択肢～ 森田 陽介 パナソニック インダストリー株式会社 メカトロニクス事業部 ファインマテリアルビジネスユニット テクノロジーイノベーション総括部 技術二部 開発五課 課長	13:30-14:30	エレクトロニクスが変える野生動物の生態調査 NPO法人 南知床・ヒグマ情報センター 主任研究員 藤本 靖 デジタルで挑む鳥獣被害対策! 横 大・横山 禎秀 マクセルフロンティア(株) DMS事業部
15:00-16:00	半導体製造装置で使われるファインセラミックスと単結晶サファイア技術 本庄 隆人 京セラ(株) ファインセラミック事業本部 機構部品事業部 機構部品商品技術部 責任者 梅原 幹裕 京セラ(株) ファインセラミック事業本部 単結晶事業部 技術部商品技術課 商品技術係 高度化する顧客ニーズへの統合最適化アプローチ（セラミックパッケージ技術の活用事例）～お客様の課題に寄り添う、最適な選定と設計へのアプローチ～ 新納 範高 京セラ(株)	14:40-16:00	エレクトロニクスの新たな用途を考える座談会 「異分野融合が拓くアプリケーション」 各講師
特別展示開催 6月10日（水）～12日（金） 10:00～17:00 東7ホール（7C-01～05）		特別展示開催 6月10日（水）～12日（金） 10:00～17:00 東7ホール（7B-06）	

●主催者企画：光電融合セミナー・展示無料

●日時：6月11日（木） ●会場：東7ホール 特設会場 ●聴講者数：215名

6月11日（木）		パネル展示
13:30-14:30	光電融合基礎の基礎・拡大する背景とその適用分野 山口 望 (株)オプトロニクス社 専務取締役	『光電融合に向けたガラスソリューション』 日本電気硝子(株)
	データセンター市場最新動向と周辺産業の役割の変化 佐々木 健一 (株)野村総合研究所 グローバル製造業コンサルティング部 チーフコンサルタント	『様々な異種ウエハの室温接合技術：原子拡散接合法 ADB』 東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室
	CPOに関連する技術・産業動向 鎌塚 洋史 (株)野村総合研究所 グローバル製造業コンサルティング部 エキスパート	『光導波路光学特性測定装置（メーカー：シナジーオプティクス株式会社）』 稲畑産業(株)
	光電融合に対する当社の取り組み 片桐 規貴 新光電気工業(株) 開発統括部 主席部長	『新規用途向け MicroThin™』 三井金属(株)
	『情報処理フォトニクス』光テクノロジーロードマップ 杉立 厚志 (一財) 光産業技術振興協会 開発部長代理	
【パネルディスカッション】 テーマ：市場予想、光電融合の技術的課題、光電融合のエコシステム 司会：(株)オプトロニクス社		

●半導体・オブ・ザ・イヤー2026

【表彰式】●日時：6月10日（水） 14:00～ ●会場：東7ホール セミナー会場10

半導体オブ・ザ・イヤー2026は、2025年4月～2026年3月の間に発表された新製品・新技術の中から産業タイムズ社にて厳正に選出いたしました。

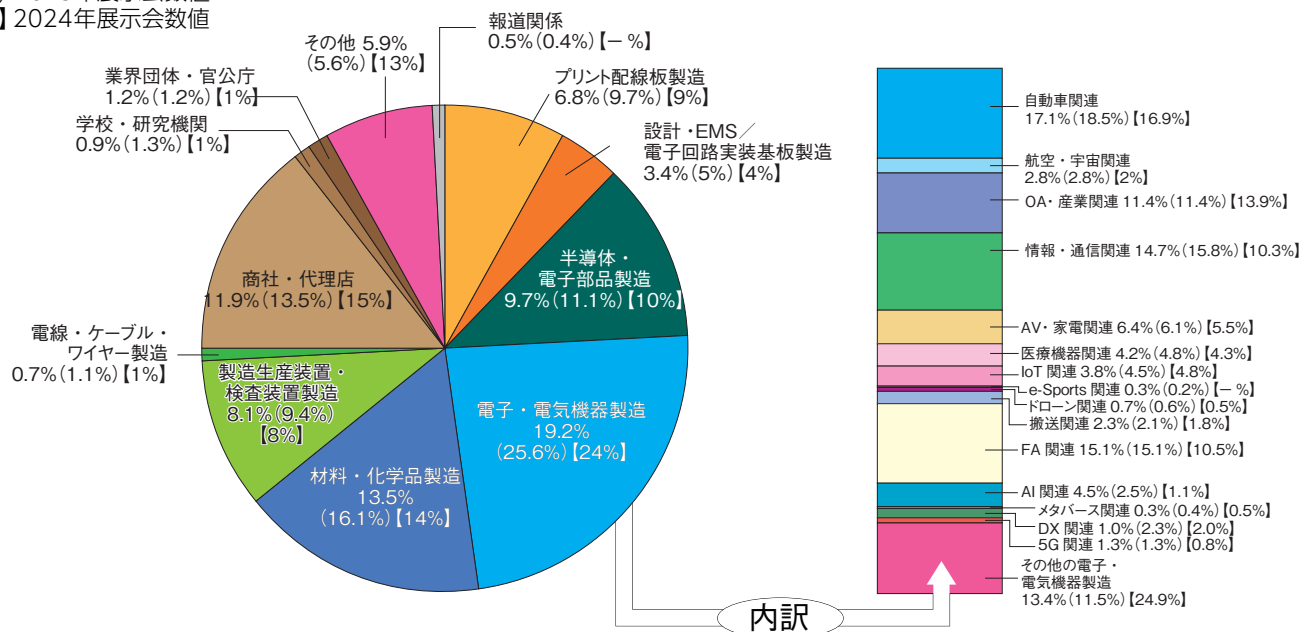
【半導体デバイス部門】		
グランプリ	NVIDIA	NVIDIA Rubinプラットフォーム
優秀賞	キオクシア株式会社	高密度・低消費電力3D DRAMの実用化に向けた高積層可能な酸化半導体チャネルトランジスタ技術の開発
	Rapidus株式会社	2nmノード GAAトランジスタの製造技術
【半導体製造装置部門】		
グランプリ	Vanguard Automation GmbH Mycronic Group	Vanguard SONATA1000 Series – Fully automated system solution for Photonic Wire Bonding and Micro-Optical Lens fabrication
優秀賞	株式会社ニューフレアテクノロジー	A14Nodeデザインルール対応マルチ電子ビームマスク描画装置「MBM™-4000」
	日機装株式会社	SiC パワー半導体向け高生産加圧焼結装置「3D Sinter」
【半導体用電子材料部門】		
グランプリ	大日本印刷株式会社	回路線幅10nmのナノインプリント用テンプレート
優秀賞	富士フイルム株式会社	PFASフリー ネガ型 ArF 液浸レジスト
	奥野製薬工業株式会社	ガラスコア基板向けスルーホールフィリング用硫酸銅めっき添加剤「トッブルチナ GCS」シリーズ

来場者分析

①来場者の業種分類

() 2025年展示会数値

【 】2024年展示会数値

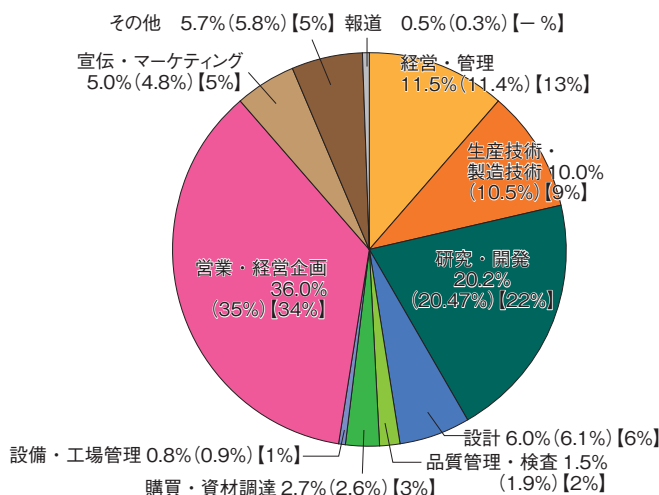


内訳

②来場者の職種分類

() 2025年展示会数値

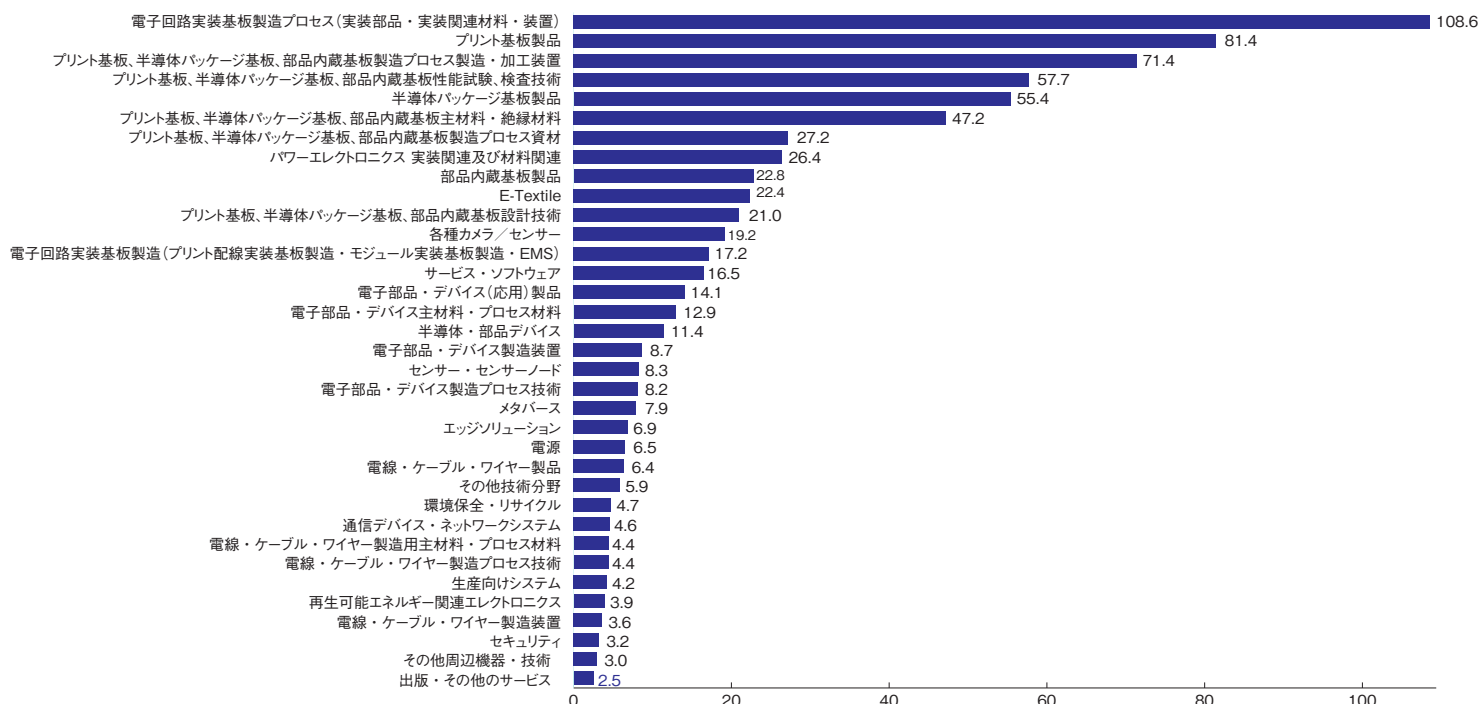
【 】2024年展示会数値



本展は総合展示会のため電子機器に関する幅広い業種の方々に来場いただき、なかでも電子・電気機器製造の方が多い。特に情報通信関連、ファクトリーオートメーション関連の伸びが大きい。

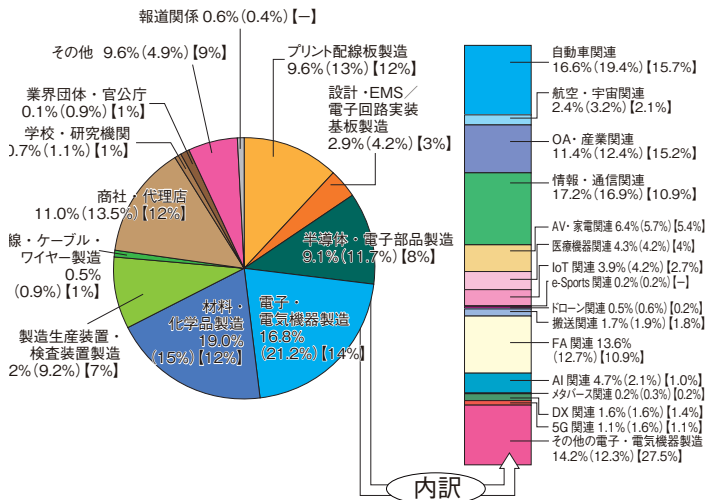
また、製品分類においては、プリント配線板製品、電子回路実装基板製造、半導体パッケージング製品への関心が高い。

③来場者が関心のある製品分類 ※複数回答

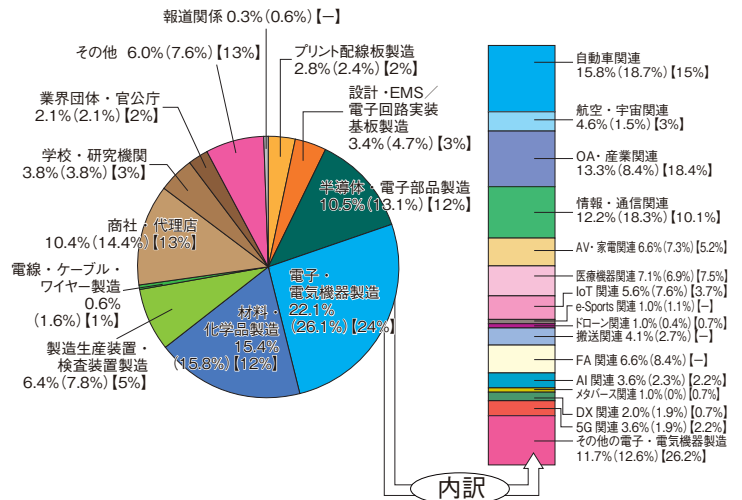


来場者分析

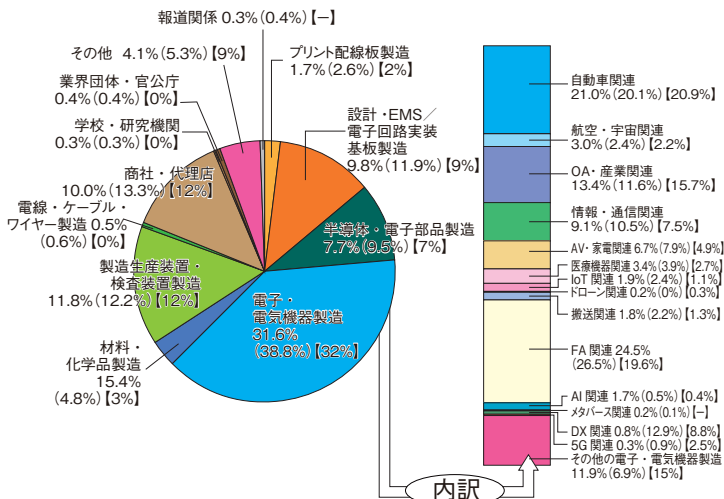
JPCA Show 2026 () 2025年展示会数値 [] 2024年展示会数値



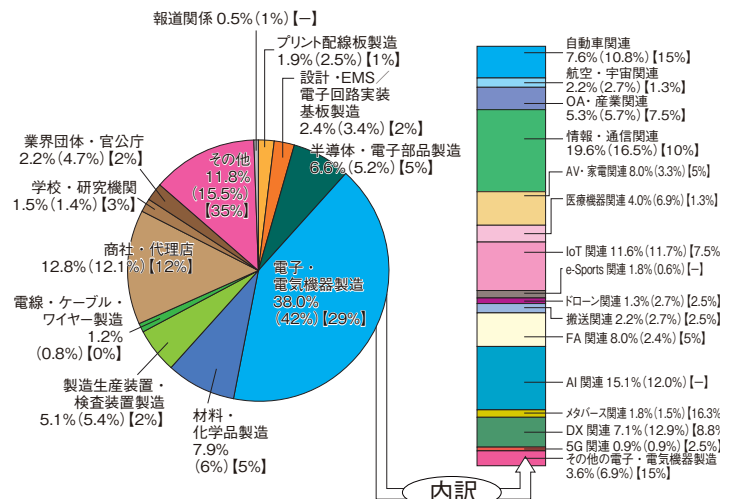
2026 マイクロエレクトロニクスショー () 2025年展示会数値 [] 2024年展示会数値



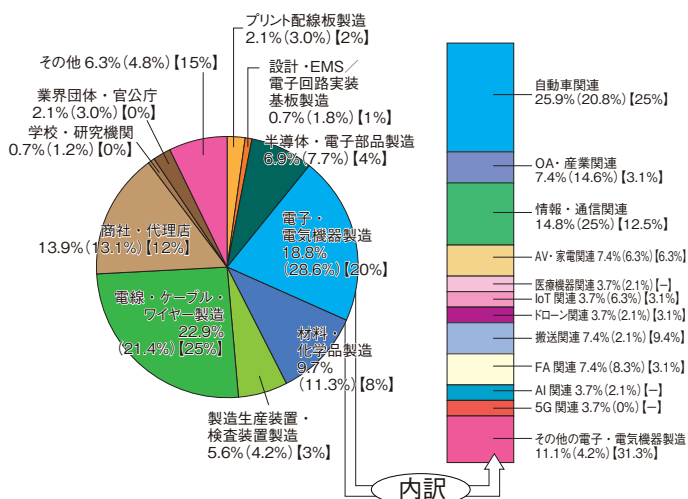
JISSO PROTEC 2026 () 2025年展示会数値 [] 2024年展示会数値



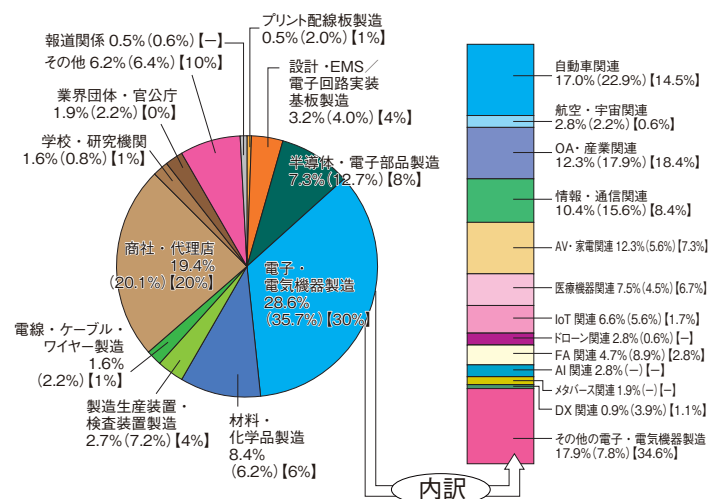
AI Device Expo () 2025年展示会数値 [] メタバースデバイス展2024数値



WIRE Japan Show 2026 () 2025年展示会数値 [] 2024年展示会数値



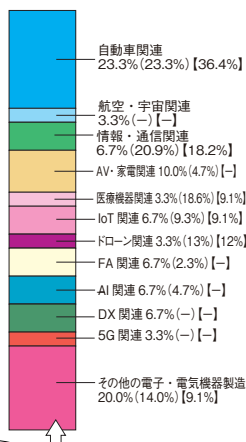
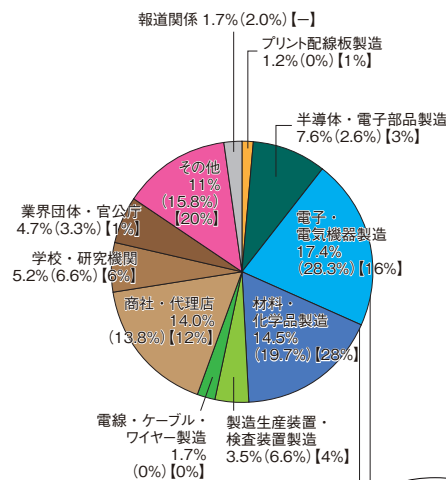
Electronics Component & Unit Show () 2025年展示会数値 [] 2024年展示会数値



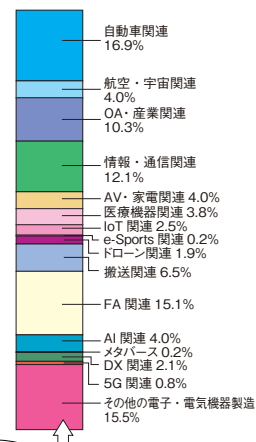
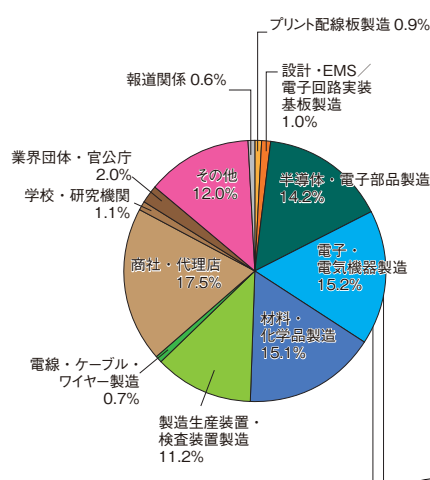
来場者分析

E-Textile/Wearable () 2025年展示会数値
 [] 2024年展示会数値

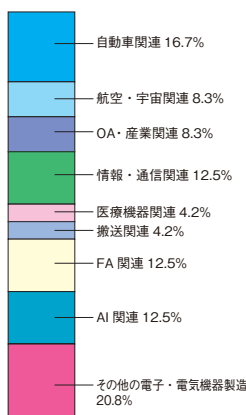
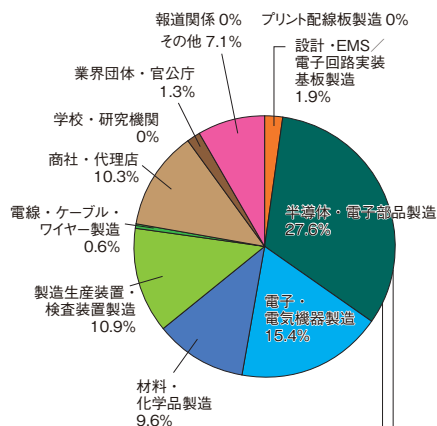
半導体産業展



内訳



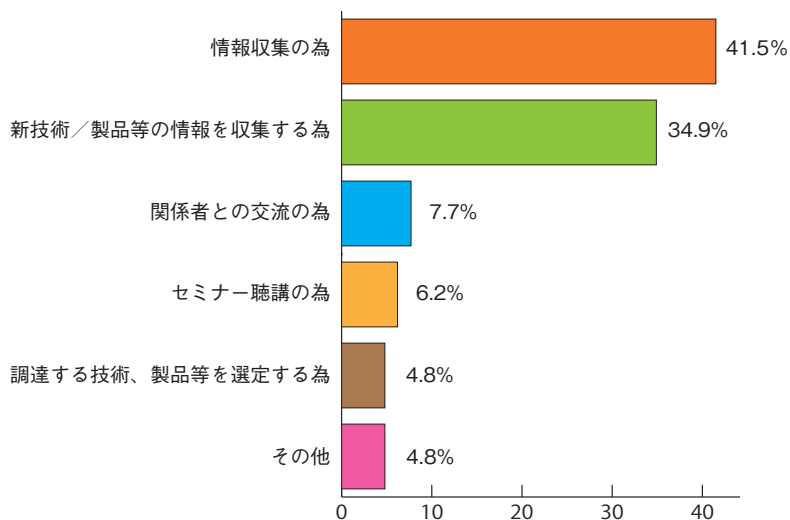
内訳



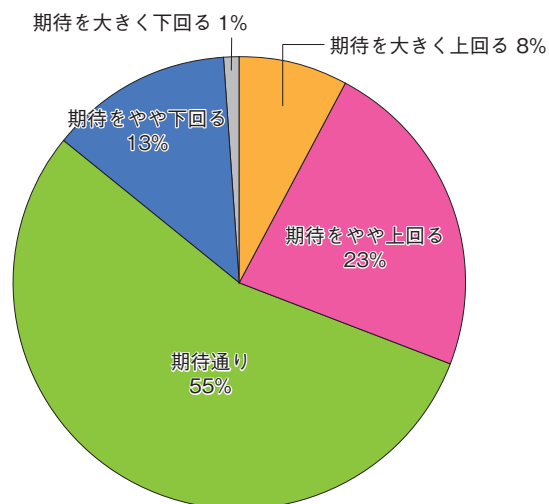
内訳

来場者アンケート

①来場目的（複数回答）

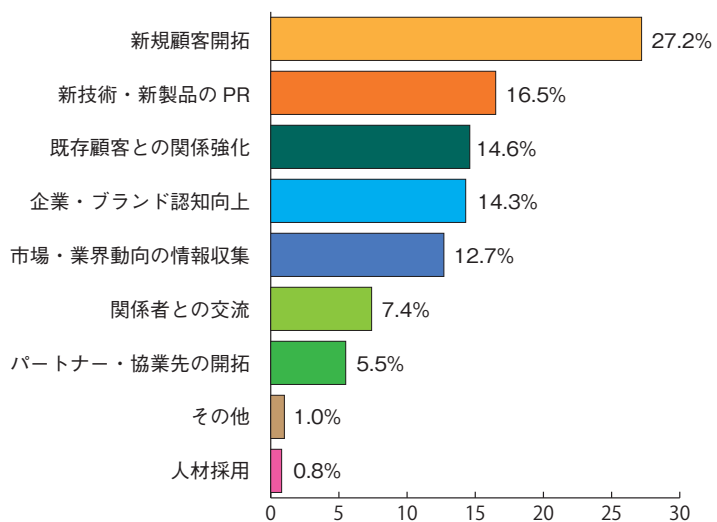


②来場成果

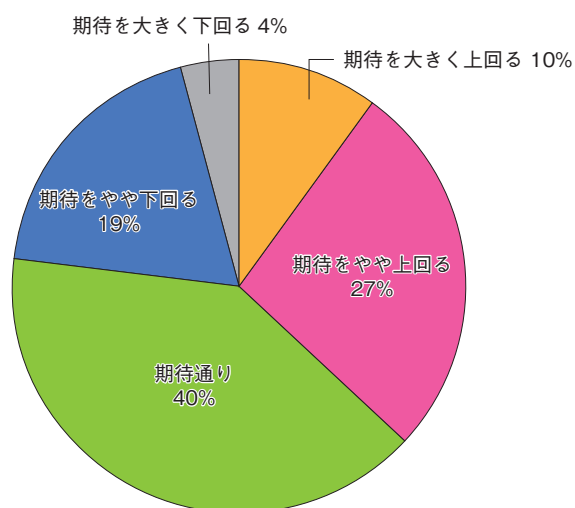


出展者アンケート

①出展目的（複数回答）



②出展成果



2026年展示会主催・運営委員会 委員

2026展示会運営委員会

委員長	高井 健郎	JPCA 副会長／太陽ホールディングス(株)
副委員長	小島 正紀	JPCA 副会長／ニッカン工業(株)
委員	松澤 浩彦	JIEP 展示会運営委員会委員長／(株)図研
委員	五十棲 丈二	JISSO PROTEC 2026運営委員会 委員長／(株)FUJI
委員	泉谷 渉	AIデバイス展共催会社会長／ (株)産業タイムズ社 (電子デバイス産業新聞)
委員	井上 政基	WIRE Japan Show 共催会社／電線新聞編集長 (電線新聞)
委員	川鍋 季明	Electronics Component & Unit Show 共催団体代表／ (株)三共社

JIEP 展示会運営委員会

委員長	松澤 浩彦	(株)図研
副委員長	中澤 正志	ソニーセミコンダクターズソリューションズ(株)
	渡辺 隆史	(一社) 日本電子回路工業会
委員	松本 博文	フレックスリンクテクノロジー(株)
	土門 孝彰	秋田銀行
	三宅 敏広	車載エレクトロニクス実装研究所
	高野 希	(株)レゾナック
	齊藤 雅之	C-NET
	菊池 浩一	TDK(株)
	中條 徳男	東京科学大学
	谷 元昭	T2 リサーチ
	森川 泰宏	(株)アルバック
	北原 悠平	奥野製薬工業(株)
	佐藤 牧子	ナミックス(株)
	加藤 義尚	福岡大学
	武田 裕一	本田技研工業(株)
	伊藤 寿浩	東京大学
	内木場文男	日本大学
	小岩 一郎	元関東学院大学
	越地 福朗	東京電機大学
	金谷 晴一	九州大学
	白石 洋一	群馬大学

2026展示会企画委員会

委員長	石川 雅昭	JPCA 理事／ 超高効率電子回路生産システム研究会
副委員長	小島 正紀	JPCA 副会長／ニッカン工業(株)
副委員長	ジュリアン・ベイショア	JPCA 理事／ ボド・メラ・ケミー・ジャパン(株)
委員	松澤 浩彦	JIEP 展示会運営委員会委員長／(株)図研
委員	五十棲 丈二	JISSO PROTEC 2026運営委員会 委員長／ (株)FUJI
委員	泉谷 渉	AIデバイス展共催会社会長／ (株)産業タイムズ社 (電子デバイス産業新聞)
委員	井上 政基	WIRE Japan Show 共催会社／ 電線新聞編集長 (電線新聞)
委員	岡本 崇義	Electronics Component & Unit Show 代表／ 岡本無線電機(株)

第27回 実装プロセステクノロジー展 運営委員会

委員長	五十棲 丈二	(株)FUJI
副委員長	富士原 寛	(一社) 日本ロボット工業会
委員	北口 浩嗣	JUKI(株)
委員	江頭 綾子	ヤマハ発動機(株)
委員	高橋 良太郎	パナソニック コネクト(株)

第27回 実装プロセステクノロジー展 実行委員会

委員長	後藤 巨樹	(株)FUJI
副委員長	公文 暁子	JUKI(株)
監査役	飯塚 剛朗	ヤマハ発動機(株)
委員	保井 吉彦	パナソニック コネクト(株)
委員	宮部 大樹	武蔵エンジニアリング(株)
委員	伊佐 吉史	オムロン(株)

第27回 実装プロセステクノロジー展 企画部会

委員長	後藤 巨樹	(株)FUJI
副委員長	公文 暁子	JUKI(株)
委員	飯塚 剛朗	ヤマハ発動機(株)
委員	保井 吉彦	パナソニック コネクト(株)



電子機器2027 トータルソリューション展

The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment 2027

2027. 6. 2 Wed. → 4 Fri.

東京ビッグサイト 東展示棟

Tokyo Big Sight, East Exhibition Halls

本部事務局 一般社団法人 日本電子回路工業会

Organizer: **JPCA** - Japan Electronics Packaging and Circuits Association

展示会に関するお問い合わせ / Inquiry

TEL : 03-5310-2020 E-mail : show@jpca.org

www.jpcaashow.com

詳細は展示会ウェブサイトへ ▶ www.jpcaashow.com/

▶ お問い合わせ先 本部事務局：一般社団法人日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2F

TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpca.org